

证券代码：688432

证券简称：有研硅

公告编号：2026-009

## 有研半导体硅材料股份公司

# 关于使用部分超募资金设立全资子公司开展新项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 超额募集资金金额及使用用途：有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”“有研硅”）拟设立全资子公司“国晶半导体材料（包头）有限公司”（公司名称以市场监督管理部门最终核定的信息为准），并以此为主体投资新建“大尺寸半导体硅单晶基地建设项目”，本项目计划总投资人民币40,000.00万元，其中拟使用超募资金194,70.15万元、自有资金20,529.85万元。

● 公司于2026年3月19日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司开展新项目的议案》。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了同意的核查意见。该议案尚需提交公司股东会审议。

● 本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

● 相关风险提示：本项目实施过程中可能存在宏观政策、市场环境、团队建设、项目进度等方面的不确定性风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

### 一、募集资金基本情况

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金总额	185,458.87万元
募集资金净额	166,396.72万元

超募资金金额	66,396.72 万元
募集资金到账时间	2022 年 11 月 7 日

## 二、超募资金使用安排

超募资金金额	66,396.72 万元
前次已使用金额	46,926.57 万元
本次使用用途及金额	<input checked="" type="checkbox"/> 新项目，大尺寸半导体硅单晶基地建设项目，194,70.15 万元

注：前次已使用金额包括永久补流使用金额 38,500.00 万元、股份回购使用金 3,593.57 万元及 8 英寸区熔硅单晶技术研发及产业化项目使用金额 4,833.00 万元。

## 三、本次使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的具体情况

### （一）项目概述

#### 1、拟设立的子公司情况

公司名称：国晶半导体材料（包头）有限公司（公司名称以市场监督管理部门最终核定的信息为准）

注册资本：40,000.00 万元

注册地：内蒙古包头稀土高新技术产业开发区

出资方式：货币出资

持股比例：100%

经营范围：硅单晶、硅片等电子专用材料制造

（注：以上拟设立子公司信息以市场监督管理部门最终核定的信息为准）

#### 2、新建项目基本情况

新建项目名称	大尺寸半导体硅单晶基地建设项目
实施主体	国晶半导体材料（包头）有限公司
实施地点	内蒙古包头稀土高新技术产业开发区
项目内容	建设约 5 万平方米的单晶厂房。厂房具备 140 个单晶炉位，可形成年产集成电路硅材料用单晶硅及集成电路刻蚀设备用单晶硅 1000 吨以上的生产能力。

项目总投资金额	40,000 万元（不包括设备投资；其中拟使用超募资金 194,70.15 万元、自有资金 20,529.85 万元）
达到预定可使用状态时间	2027 年 12 月

## （二）项目必要性分析

### 1、紧抓市场发展机遇，满足日益增长的市场需求。

随着物联网、人工智能、汽车电子、大数据和区块链等新兴技术的快速发展以及移动终端的持续普及，市场对半导体产品的需求不断攀升，尤其是 8/12 英寸大尺寸硅片的需求增长尤为迅速。同时，随着刻蚀工艺在芯片制造中步骤和重要性的不断提升，作为刻蚀反应核心部件材料的技术迭代速度加快，市场需求持续扩大。为紧抓市场发展机遇，公司需加快合理布局产能，不断提高产业化能力。建设单晶制造基地，计划对 8 英寸硅片及零部件实施扩产，以进一步提升公司产品的供货能力，巩固并提高产品的市场占有率和盈利能力。

### 2、优化产业布局、夯实产业基础，助力公司战略目标的实现。

有研硅致力于成为世界一流半导体企业，在当前产业规模上仍处于追赶阶段。为此，公司需分阶段推进产能提升，依据市场需求合理提升 8 英寸硅片及半导体零部件的产能，不断做大做强。目前公司单晶厂房无法满足扩产需求，本项目选址内蒙古包头，能充分利用当地电力成本优势，提升产品竞争能力的同时，增强企业的盈利能力。通过实施本项目，将有助于推进公司半导体硅片规模化发展，同时为“十五五”规划期间布局石英坩埚、多晶铸锭等新兴业务领域奠定基础，增强整体竞争力和行业影响力，推动公司发展战略的稳步落地。

## （三）项目可行性分析

### 1、国家产业政策为行业发展筑牢基石保障。

国家“十四五”规划明确将半导体材料列为攻关重点，经过五年发展，国内半导体硅材料和零部件产业取得了长足进步，为后续突破奠定了较好基础。“十五五”是我国全面实现半导体材料国产化的战略机遇期，国际环境、国内政策将持续支持半导体硅片和零部件产业发展，为该领域注入强劲动能。硅片和零部件作为半导体材料产业链的基础核心环节，市场规模较大，国产化替代空间较大，这为公司战略布局提供了明确方向。

### 2、核心技术体系为项目实施提供了硬核支撑。

公司自成立以来，始终专注于半导体硅材料的研发、生产与销售，是国内最早从事半导体硅材料研发并率先实现产业化的单位。通过突破并优化多项关键技术，公司构建了自身的技术壁垒。截至目前，公司已获得多项硅片及半导体零部件生产工艺相关专利，形成具有自主知识产权的核心技术体系，为项目的顺利实施提供了有力支撑。

3、长期稳定的客户资源为项目推进奠定了坚实的市场基础。

公司所处行业为集成电路先进制造领域，对产品质量、精细控制有较高要求，下游客户验证通常需要经历较长周期。公司长期秉承“技术领先，质量可靠，诚信进取，客户满意”的质量方针，已积累了一批长期稳定的核心客户群，与公司形成了紧密的战略合作关系。本项目将有力提升单晶材料的供应保障能力，符合市场和客户的预期，进一步巩固与深化现有客户的合作关系，为项目新增产能的顺利释放提供市场支撑。

#### （四）项目经济效益分析

项目的顺利实施将有助于公司扩大收入规模，提高公司产品的市场占有率和盈利能力。根据测算，在实现预期投入产出的前提下，项目税后内部收益率处于良好区间，动态投资回收期合理，项目具备经济可行性。

#### （五）项目主要风险分析

##### 1、政策风险

尽管目前内蒙古包头在电力成本方面具有显著优势，但鉴于国家和各地新能源政策调整较为频繁，未来包头地区的电价政策及优惠力度存在不确定性。若相关政策发生不利变化，可能导致当地电力成本优势减弱，从而对项目的预期收益产生一定影响。

##### 2、市场风险

本项目的市场风险主要表现为：一是半导体行业具有周期性特点，其景气度受宏观经济及下游消费电子、汽车电子、通讯等领域的波动影响显著。一旦市场进入下行周期，对新项目产能消化和营收稳定将构成挑战。二是伴随全球芯片制造产能向中国大陆转移，中国大陆市场将成为全球半导体硅片企业竞争的主战场，公司未来将面临国际先进企业和国内新进入者的双重竞争，面临未来市场竞争加剧的风险。三是硅材料产品价格存在波动或下降的风险，从而可能拉长投资回报

周期。

### 3、团队建设风险

本项目选址内蒙古包头建设，部分关键技术骨干可能会因个人职业规划、家庭安置或子女教育等现实因素，赴异地工作的意愿不高，对新公司核心团队建设带来挑战。

### 4、项目进度未达预期的风险

公司使用部分超募资金设立全资子公司开展新项目，是基于当前的经济形势、行业前景进行的慎重决策。但在项目实施过程中，受内蒙古包头当地施工限制及各项行政审批等因素影响，可能存在项目进度未达预期的风险。

### （六）保障募集资金安全的措施

公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定使用和管理募集资金，并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。董事会授权公司管理层办理新设子公司开立募集资金存放专用账户相关事宜，专项存储本次公司投入的募集资金，新设子公司将与公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储四方监管协议。

## 四、适用的审议程序及保荐人意见

### （一）履行的审议程序

2026年3月19日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司开展新项目的议案》。本次超募资金使用事项尚需提交公司股东会审议。

### （二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：有研硅本次使用部分超募资金设立全资子公司开展新项目，已经上市公司董事会审议批准，履行了必要的程序，尚需提交公司股东会审议，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

综上，保荐机构对公司使用部分超募资金设立全资子公司开展新项目的事项无异议。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2026年3月20日